杭州长川科技股份有限公司

2024 年度总经理工作报告

2024年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。

在此，我谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董事会汇报如下：

一、年度经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入364,152.60万元，同比上升105.15%；归属于上市公司股东的净利润45,843.33万元，同比上升915.14%。基本每股收益为0.73元，较上年同比上升942.86%。

二、2024 年度主要工作回顾

2024年，公司法人治理体系构建完善、“三会”运作规范，期间共召开十一次董事会、十次监事会、一次年度股东大会、三次临时股东大会。报告期内，公司加强内控规范和财务管理水平，在公司董事会领导下，经理层加大了规范管理、优化流程、内控治理、学习培训等规范工作力度。

纵观2024年，面对全球半导体行业复苏和国产化替代加速的双重机遇，归功于国家对集成电路产业关注度不断提升，同时得益于公司研发项目不断加大投入，产品线不断丰富，大客户战略得到深化，小客户不断开发等多方面积极作用，公司的市场形象、品牌价值、核心竞争力得到了显著提升。公司积极部署研发战略和发展方向，贯彻落实年度经营计划，把握机遇，迎接挑战。尽管全球贸易摩擦余波未平、经济环境复杂多变，但公司凭借国家对集成电路产业政策的持续利好，以及自身在研发创新领域的深耕细作，精准把握行业复苏脉搏，灵活调整经营策略，既顺应市场结构性增长趋势，又前瞻性布局风险防控机制，通过优化客户服务体系与强化内部管理效能，有效应对外部不确定性。技术创新层面，公司加速科技成果转化，推动新产品商业化进程，同时加快新产业基地建设步伐，为未来增长蓄能。此外，公司国际化战略深入实施，海外产能布局成效显著，不仅增强

了全球供应链的韧性，也进一步拓宽了国际市场版图，为公司的长远发展构筑了更为稳固的基石。报告期公司实现了销售额、净利润的较大幅度增长。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、坚持自主研发，加大研发投入

公司始终坚持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、探针台、AOI设备、自动化设备等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发团队力量，同时与国内知名院校就业办加强了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。以多年持续技术创新为基础，公司继续深化已掌握的集成电路测试设备的相关核心技术，报告期内，继续加大研发投入力度，2024年研发经费投入达102,465万元，占营业收入比例为28.14%，公司基于持续开拓高端市场的考虑，2024年研发投入较上年仍大幅上升。

2、贯彻“以客户为中心”扩大销售规模

公司不断培养员工强化“以客户为中心”的文化理念，继续深化客户战略，服务好客户，加强市场推广力度，进一步提升公司品牌价值；巩固和提高现有客户销售规模，进一步提高公司在新增客户中的影响力和占有率，积极开发导入新的客户，立足国内市场的同时，积极开拓国际客户，报告期内公司继续开拓海外市场的同时，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化；同时，公司扩大了产品市场份额以及产品的应用领域，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。

3、集成电路高端智能制造基地建设完成

报告期内，集成电路高端智能制造基地项目基本建设完成，计划于2025年第二季度正式投产。

4、公司治理

报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，修订了《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。

5、人才发展

人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的力量，大力实施人才战略。报告期内，公司开展新员工入职培训工作和导师培训工作，通过系统的培训，员工理念明显提升，管理技能得到加强。公司校招及社招一直有序进行，从外部招聘部分社招人才，并从一批985、211高校中挑选了大批优秀毕业生，为公司未来的可持续发展提供了人才保障。

二、2025年主要工作目标

（一）公司未来发展战略

根据半导体行业内“一代设备，一代工艺，一代产品”的经验，半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺，而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品，公司秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业文化精神，在将现有产品领域做专、做强，保持产品市场领先地位的基础上，重点开拓各类数字芯片测试设备、三温分选设备、AOI检测量测设备及封装相关设备等，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场，将公司打造成提供国际一流的集成电路装备供应商。

公司在深入研究集成电路装备业发展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式：

1、产品深度方向。发挥现有核心技术优势，不断探索产品技术深度，力求将产品做精、做专，不断提高产品的市场竞争力；

2、产品线宽度方向。通过市场调研、产品规划、现有技术延展、新技术的研究，不断开发新的产品线，为公司的发展开拓新的增长点；

3、市场开拓方向。不断提升公司研发水平、产品品质，加强公司品牌建设，从中低端市场向中高端市场、从国内市场向国外市场开拓，将公司打造成为国际集成电路装备业的知名品牌。

（二）经营举措

为实现公司的未来发展战略，进一步提升可持续发展能力和核心竞争力，2025年围绕战略规划，公司制定了各项经营举措具体如下：

1、优化资源配置，扩大公司产能；

- 2、公司级PMO等体系建设；
 - 3、加快高端智能制造基地的建设工作；
 - 4、继续加大研发投入，加强技术创新和新产品开发，持续优化产品设计，提升企业竞争力；
 - 5、强调以客户为中心，聚焦重点客户，布局主流客户，挖掘潜在客户，提升老客户，带动市场份额继续快速扩张；
 - 6、注重人才管理，推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的人才发展体系，引进市场优秀人才，关注员工的职业生涯管理，激发员工积极性，挖掘公司员工创造力和潜在动力；
 - 7、加强内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保企业稳健成长；
 - 8、持续加强企业价值管理，塑造品牌价值。
- 2025年公司经营管理团队将认真履责，努力进取以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

杭州长川科技股份有限公司

总经理：赵 轶

2025年4月28日